

各位

会社名 株式会社テクニスコ
代表者名 代表取締役社長 関家圭三
(コード番号：2962 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務取締役経営サポート本部長 相原 正行
(TEL. 03-3458-4561)

THE GOODSYSTEM CORP. との業務提携に向けた基本合意について

株式会社テクニスコ（東京都品川区、代表取締役社長 関家圭三、以下 当社）は、高機能ヒートシンク領域における製品ラインナップ拡充と開発力強化のため、THE GOODSYSTEM CORP.（韓国京畿道安山市、代表取締役社長 曹明煥、以下 TGS 社）と業務提携検討に向けて基本合意いたしました。

非常に高い放熱性能（熱伝導率）を持つ当社初の独自材料、シルバーダイヤに TGS 社の製品群を加えることで、高機能ヒートシンクに求められるマーケットのニーズをより広くカバーすることができます。



※arCuDia（アルカディア）、SbS-Dia.、SbS-Cu は TGS 社の製品です

具体的な提携の内容は今後詰めてまいります。顧客の相互紹介、マーケティングに関する情報共有、相互の技術活用などを想定しております。当社は、TGS 社との提携で得られた知見や顧客とのつながりを足掛かりに、シルバーダイヤをはじめとする高機能ヒートシンク製品のさらなる拡販に努めてまいります。

【THE GOODSYSTEM CORP. の概要】

本社：韓国京畿道安山市

CEO/社長：曹明煥 工学博士（東北大学）

CTO/副社長：李錫雨 工学博士（東北大学）

設立：2016年5月31日

事業内容：高性能金属複合放熱素材／半導体パッケージ用放熱基板の製造・販売

URL：<http://thegsystem.co.kr/>

以上